

1775470-8 ✓ 有效



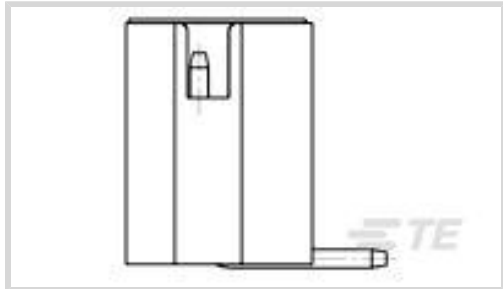
HPI

TE 内部编号 1775470-8

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 8 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin, Surface Mount, Signal, Natural, Reel, HPI

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > AMP HPI 2.0 mm Headers



连接器系统: 线到板

位数: 8

行数: 1

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: 垂直

[所有 AMP HPI 2.0 mm Headers \(205\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 连接器系统 | 线到板 |
| 接头类型 | 全部带罩 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

结构特性

| | |
|----------|----|
| 位数 | 8 |
| 行数 | 1 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

电气特征

| | |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

主体特性

| | |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

| | |
|---------|-----------------|
| 端子接触部长度 | 3.5 mm[.138 in] |
| 接合方柱尺寸 | .5 mm[.02 in] |

| | |
|--------------------|--------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 2 μm[80 μin] |
| 端子布局 | 直插式 |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| 端子形状和构造 | 正方形 |
| 端子接触部电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| 端子底板材料 | 镍 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 镍 |
| 端子基材 | 黄铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 锡 |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子额定电流 (最大值) | 3 A |

端接特性

| | |
|-------------|---------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .5 mm[.02 in] |
| 端接柱体和尾部长度 | 2 mm[.079 in] |
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |

机械附件

| | |
|------------|--------|
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |
| 接合固定 | 不带 |
| PCB 安装固定类型 | 焊钉 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准 | 带有 |
| PCB 安装对准 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 带有 |

壳体特性

| | |
|----------|---------------|
| 外壳材料 | PA 9T GF |
| 中心线 (间距) | 2 mm[.079 in] |

尺寸

| | |
|-------|------------------|
| 连接器长度 | 19.4 mm[.764 in] |
| 连接器高度 | 6.15 mm[.242 in] |
| 连接器宽度 | 5.4 mm[.213 in] |

使用环境

| | |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -25 – 85 °C[-13 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|



操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装数量 | 500 |
|------|-----|

| | |
|------|------|
| 封装方法 | Reel |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 260°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | HPI



客户还购买了



文档

产品图纸

HPI CONN., 2.0MM, V/T, SMT, 8P, 80U"

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1775470-8_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1775470-8_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1775470-8_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[HPI Connectors QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本